

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东北证券—王浩然、李玖、王动 望正资产—马力 东方自营—朱凌昊 平安基金—李曾卓卓 拾贝投资—陈俊 南方基金—吴凡 进门财经—刘婷 西南自营—刘淑娴 中信建投资管—徐博 淳厚基金—吴若宗 东北固收转债—胡嘉祥 海螺创投—樊生龙 恒大人寿—邓凌宇 博时基金—赵宪成 中信自营—罗舜芝、胥洞菡 创金合信基金—周志敏 喜世润—张亚北 上银基金—卢扬 国泰基金—刘波 中银国际资管—阳桦 东方基金—梁忻 尚近投资—赵俊 茂源财富—钟华 海通资管—邵宽 富荣基金—郎骋成 中邮基金—俞科进 金信基金—黄飙 尚近投资—赵俊 中银国际资管—武苇杭 永赢基金—张海啸 宁泉资本—张斌 兴业基金—肖滨 禾永投资—焦云 慧琛基金—王煜明

	<p>乘安资产—周焜煜 太平洋资产—王磊 九泰基金—谭劭杰 华泰证券资管—李勇剑 生命人寿—黄进 顶天投资—朱登科 汐泰投资—李佳星</p> <p><b>天弘基金—张韬</b></p> <p><b>开源证券—刘翔、盛晓君</b></p> <p>信达澳亚—齐兴方 华泰资产—范文琪 海富通—王经纬</p> <p><b>东亚前海证券—陈杨、高力洋</b></p> <p>广发基金—王小罡 宝盈基金—诸晓琳 九泰基金—谭邵杰 格林基金—李玉杰 弘毅远方基金—赵阳 中海基金—王泉涌 华富基金—范亮 工银瑞信—梁妍 华泰柏瑞—李学涛</p> <p><b>东方财富证券—刘溢</b></p> <p>西安博成基金股份有限公司—许伦嘉 安徽航源基金—姚丹平 成都海川汇富—黄昱诚 鸿涵投资—呼振翼 浙江探骊—陈琢</p> <p><b>鹏华基金—王威</b></p> <p><b>海富通基金—郑敏宏</b></p>
会议时间	<p>2022 年 4 月 26 日 9:00—9:50 (东北证券)</p> <p>2022 年 4 月 26 日 10:00—11:00 (天弘基金)</p> <p>2022 年 4 月 26 日 15:00—16:00 (东亚前海证券)</p> <p>2022 年 4 月 27 日 14:00—16:50 (开源证券)</p> <p>2022 年 4 月 28 日 10:00—11:00 (东方财富证券)</p>

	2022 年 4 月 28 日 15: 00—15: 50 (鹏华基金) 2022 年 4 月 28 日 17: 00—17: 30 (海富通基金)
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书: 张家铨先生, 公司董秘办主任、证券事务代表: 沈志鹏先生, 公司证券事务与投资者关系管理专员: 秦境凤女士、虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2022年第一季度报告营收情况。</b></p> <p>各位投资者好! 欢迎大家参加此次的调研活动。</p> <p>公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售, 具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片, 分别为: 晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括: TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等)、二极管器件和芯片(包括: 整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等)、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。目前, 公司的晶闸管系列产品、二极管及防护系列等产品采用垂直整合(IDM)一体化的经营模式, 即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体; 公司的MOSFET系列产品采用Fabless+封测的业务模式。</p> <p>公司2022年第一季度, 在客户端的支持与关心下, 在全体员工的共同努力下, 实现营业收入374, 125, 658. 74元, 较上年同期增长2. 46%; 实现利润总额117, 344, 407. 38元; 归属于上市公司股东的净利润为100, 370, 955. 98元, 较上年同期增长了0. 08%; 报告期内总资产达6, 150, 371, 234. 38元, 比上年度末增加7. 40%。</p>

## 二、主要交流问题

### 1、公司2022年第一季度晶闸管、防护器件和MOS的营收占比？

答：报告期内，实现营业收入374,125,658.74元。其中公司晶闸管（芯片+器件）营业收入占公司2022年第一季度营业收入的23.22%；防护器件（芯片+器件）营业收入占公司2022年第一季度营业收入的31.46%；MOSFET（芯片+器件）占公司2022年第一季度营业收入的42.35%，同比增加了12.36%。

### 2、公司生产运营受到疫情影响是否严重？

答：国内疫情防控的形势依旧严峻，公司密切关注疫情发展态势，严格落实和完善常态化疫情防控举措并建立了应急处理办法，积极做好相关防控工作。在订单获取工作上也采取了线上、线下双轮驱动的模式与新老客户进行沟通、交流，甄选更多优质客户进行合作。目前，公司产能集中在南通市苏锡通园区和启东市经济开发区，疫情对公司原材料的运输和产品的发货造成了一定的影响，对公司经营管理、生产销售暂未受到大的影响。

### 3、公司目前上游原材料的涨价压力大吗？是否有涨价计划？

答：公司产品价格会随着外部环境、竞争态势变化而调整，以保持竞争优势，出现上游材料涨价情况公司会先进行内部自我消化，如果涨价幅度过大公司才会考虑对产品价格作出相应调整。目前公司上游原材料供应稳定，受疫情影响不重，生产经营一切正常，暂无涨价计划。

### 4、请介绍一下公司6英寸项目，目前项目进展如何？

答：由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建的“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目，计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务于公司晶闸管及二极管等业务。该项目除了可以扩大现有防护器件

的产能，由于产品的更新迭代，我们还会做一些更高端的二极管，也会做一些IGBT小信号的模块。主要产品为快恢复二极管芯片及器件，IGBT模块配套用高电压大通流整流芯片，低电容、低残压等保护器件芯片及器件，中高电压功率集成芯片，平面可控硅芯片及其他芯片产品等。该项目资金来源为捷捷半导体有限公司自有资金，总投资5.1亿元人民币。目前，该项目已经开工，计划明年建设完成，其中六英寸晶圆“中试线”已具备试生产能力，首批具有高浪涌防护能力的六英寸晶圆于2022年3月26日产出下线，良率高达97.79%。该项目投产后，产品可广泛应用在计算机系统、安防通讯、交/直流电源、汽车电子、家用电器、仪器仪表、消费电子、数字照相机等市场领域，实现电路的共/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电磁波干扰抑制、静电抑制、及瞬态噪声抑制等。具有广阔的市场前景，将大大拓宽原有的产品线，有效减少了国内市场对进口芯片的依赖。该项目目前已组建了近50人的专业团队，由半导体领域专家、高级工程师，以及拥有多年大型晶圆生产企业工作经验的资深工程和技术专家组成，为快速实现高质量达产达效提供了有力的技术支持。项目达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力。

**5、公司可转债募投项目以及高端功率半导体器件产业化项目进展怎么样？**

答：公司可转债募投项目：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成20亿的销售规模。目前项目进展：已经开工建设，建设期在2年左右。

公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区内，是配套无锡和上海MOSFET团

队，目前项目（一期）正在基础设施及配套等建设的最后阶段，计划今年第三季度开始试生产。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等。

**6、请介绍一下公司无锡和上海MOSFET的业务情况：**

答：公司在2017年引进了无锡MOS团队，主要是研发销售的是TRENCH MOSFET，产品有高压VDMOS、中压VDMOS及低压VDMOS，TRENCH MOSFET主要用于开关电源、照明、高能效家电、工业、通讯等领域；2019年引进了上海MOS团队，主要研发销售的是SGT MOSFET，其主要应用于汽车电子、消费、家电、工业、通讯等。2021年度公司MOSFET团队超额完成营收目标，实现营收5.24亿元，占2021年度总营业收入的29.57%，在今年有望部分超结MOSFET量产产品推向市场。公司MOSFET业务采用的是Fabless+封测模式，MOSFET芯片是由公司无锡和上海团队设计，委外流片，其中芯片（8英寸为主）全部委外流片，6英寸主要通过杭州立昂微和四川广义等，8英寸是中芯集成等，12英寸是广州粤芯等。封测方面以委外代工为主、自封为辅，目前我们自封30%，还有70%是委外的，测试以我们自己为主。

**7、公司未来重点的发展方向是什么？是否有产品应用于新能源汽车电子？**

答：公司下游客户分布分散，应用领域十分宽泛，目前按照产品的应用领域不同大致分为：白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、光伏、电动工具和摩配等。未来公司将重点拓展三大市场：汽车电子（主要为各类马达驱动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等）；电源类（主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器件需求等）；以及工业类（主要为高功率马达驱动，锂电池管理，逆变器，压缩机等）。公司在新能源汽车方面，已有部分TVS产品用于充电桩上，主要是提供安全保

	护，合作客户有东风、罗思韦尔等。此外，公司聚焦新能源汽车和智能电网等应用，推出车规级 SGT MOSFET 器件，推出的十三款车规级功率 MOSFET，严格遵循了 IATF 16949 品质管理体系及 AEC-Q101 可靠性验证标准，部分产品已在新能源车上实现车用，今年将陆续会有新的车规级新产品推向市场。
附件清单（如有）	无
日期	2022-4-28